



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS  
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL, INOVAÇÃO, COMERCIO E  
SERVIÇOS**

**CONSULTA PÚBLICA Nº 03 - SEI, 17 DE ABRIL DE 2024**

A Secretaria de Desenvolvimento Industrial, Inovação, Comércio e Serviços do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, de acordo com os artigos 8º e 9º da Portaria Interministerial SEPEC-ME/MCTIC nº 32, de 15 de julho de 2019, torna pública a proposta de alteração do Processo Produtivo Básico – PPB de APARELHO TELEFÔNICO POR FIO CONJUGADO COM APARELHO TELEFÔNICO PORTÁTIL SEM FIO, QUE INCORPORE CONTROLE POR TÉCNICAS DIGITAIS.

O texto completo está disponível no sítio da Secretaria, no endereço: <https://www.gov.br/mdic/pt-br/assuntos/competitividade-industrial/processo-produtivo-basico-ppb/consultas-publicas-de-ppb-1/consultas-publicas-de-ppb-2024>

As manifestações deverão ser encaminhadas no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da data de publicação desta Consulta no Diário Oficial da União, a todos os seguintes e-mails: [cgel.ppb@mdic.gov.br](mailto:cgel.ppb@mdic.gov.br), [cgia@mcti.gov.br](mailto:cgia@mcti.gov.br), [cgtd@mcti.gov.br](mailto:cgtd@mcti.gov.br) e [cgpri.ppb@suframa.gov.br](mailto:cgpri.ppb@suframa.gov.br).

**UALLACE MOREIRA LIMA**

Secretário de Desenvolvimento Industrial, Inovação, Comércio e Serviços

## ANEXO

**PROPOSTA Nº 001/24 – ALTERAÇÃO DO PROCESSO PRODUTIVO BÁSICO PARA APARELHO TELEFÔNICO POR FIO CONJUGADO COM APARELHO TELEFÔNICO PORTÁTIL SEM FIO, QUE INCORPORA CONTROLE POR TÉCNICAS DIGITAIS, ESTABELECIDO PELAS PORTARIAS INTERMINISTERIAIS MDIC/MCT Nº 174 E Nº 175, DE 03 DE OUTUBRO DE 2007.**

**OBS.:** A consulta está em forma de Portaria na versão da Lei de Informática, mas também vale para a versão da Zona Franca de Manaus.

Art. 1º O Processo Produtivo Básico do produto APARELHO TELEFÔNICO POR FIO CONJUGADO COM APARELHO TELEFÔNICO PORTÁTIL SEM FIO, QUE INCORPORA CONTROLE POR TÉCNICAS DIGITAIS, industrializado no País, passa a ser composto pelas etapas e respectivas pontuações relacionadas na tabela constante do Anexo desta Portaria Interministerial.

§ 1º Os pontos totais serão atribuídos a cada etapa de produção realizada, conforme o disposto no Anexo desta portaria, sendo que a empresa deverá acumular no mínimo 358 (trezentos e cinquenta e oito) pontos por ano-calendário .

§ 2º O projeto de desenvolvimento a que se refere a etapa I do Anexo desta portaria só será pontuado para produto que atenda às especificações, normas e padrões adotados pela legislação brasileira e cujas especificações, projetos e desenvolvimentos tenham sido realizados no País, por técnicos de comprovado conhecimento em tais atividades, residentes e domiciliados no Brasil e atendam às Portarias específicas do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação - MCTI.

Art. 2º O investimento em Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação Adicional (PD&IA) ao exigido pela legislação a que se refere a etapa II do Anexo desta portaria deverá ser aplicado em programas e projetos de interesse nacional nas áreas de tecnologias da informação e comunicação considerados prioritários pelo Comitê da Área de Tecnologia da Informação – CATI.

§ 1º O investimento a que se refere o **caput** deste artigo deverá ser calculado sobre o faturamento bruto anual incentivado no mercado interno, decorrente da comercialização dos produtos a que se refere esta Portaria, nos termos dos §§1º e 2º do art. 9º do Decreto nº 10.356, de 20 de maio de 2020.

§ 2º A comprovação do investimento em PD&IA deverá ser apresentada de forma discriminada junto com o relatório descritivo referente à obrigação estabelecida na Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991.

§ 3º Para efeito do disposto no **caput** deste artigo, serão considerados como aplicação em atividades de PD&IA do ano-calendário os dispêndios correspondentes à execução de tais atividades realizados até 31 de março do ano subsequente.

Art. 3º Sempre que fatores técnicos ou econômicos, devidamente comprovados, assim o determinarem, a realização de qualquer etapa do Processo Produtivo Básico poderá ser suspensa temporariamente ou modificada por meio de portaria conjunta dos Ministérios do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços e da Ciência, Tecnologia e Inovação.

Art. 4º Fica revogado a Portaria Interministerial MDIC/MCT nº 175, de 03 de outubro de 2007.

Art. 5º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

#### ANEXO

<b>Etapas</b>	<b>ETAPAS PRODUTIVAS</b>	<b>PONTUAÇÃO</b>
I	Projeto e desenvolvimento no país - Portaria MCT nº 950, de 12 de dezembro de 2006, ou Portaria MCTI nº 1.309, de 19 de dezembro de 2013, ou Portaria MCTIC nº 356, de 19 de janeiro de 2018, Portaria MCTIC nº 3.303, de 25 de junho de 2018 ou Portaria MCTI nº 4.514, de 2 de março de 2021.	112
II	Investimento adicional em PD&I, valendo 10 pontos para cada 1% investido adicionalmente em PD&I, limitado a um máximo de 40 pontos.	40
III	Desenvolvimento do software embarcado de baixo nível (firmware).	10
IV	Injeção, moldagem, impressão 3D, ou outro processo de conformação plástica da Base e Portátil.	51
V	Fabricação dos capacitores a partir do encapsulamento.	103
VI	Furação, transferência de imagem, corrosão, acabamento mecânico e teste elétrico das placas de circuito impresso da base.	59
VII	Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso da Base.	54
VIII	Furação, transferência de imagem, corrosão, acabamento mecânico e teste elétrico das placas de circuito impresso do Portátil.	83
IX	Montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso do Portátil.	58

X	Furação, transferência de imagem, corrosão, acabamento mecânico e teste elétrico das placas de circuito impresso do conversor CA/CC.	19
XI	Montagem e soldagem de todos os componentes na placa que implemente a função de conversor CA/CC.	95
XII	Corte, decapagem, crimpagem ou soldagem do cabo do conversor CA/CC.	14
XIII	Corte, laminação e montagem do circuito flexível com tinta condutiva para formação da membrana condutiva do teclado.	74
XIV	Montagem da tela de plasma, LCD ou LED no substrato, conexão dos circuitos de controle, soldagens ou conexões e encapsulamento do display.	327
XV	Montagem e soldagem de todos os componentes na placa de circuito impresso do módulo transceptor, quando não integrada à placa principal.	38
XVI	Empilhamento ou montagem dos eletrodos, inserção do eletrólito, encapsulamento da célula da bateria em invólucro e vedação hermética.	106
XVII	Integração das placas de circuito impresso e das partes elétricas e mecânicas na formação final do produto.	30
XVIII	Testes.	30
	<b>Total</b>	<b>1.303</b>
	<b>Meta</b>	